

柏騰科技 (3518)

法人說明會

日期：2025 / 05 / 23

免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之預測性資訊，包括營運展望、財務狀況及業務預測等內容，係本公司基於內部資料及外部整體經濟發展現況所得之資訊。
- 本公司未來實際產生的營運結果、財務狀況與業務成果，可能與預測性資訊有所差異，其原因可能來自各種因素，包括但不限於市場需求、各種政策法令與整體經濟現況之改變，以及其他本公司無法掌控之風險等因素。
- 本簡報中所提供之資訊，係反應本公司截至目前為止對於未來的看法，並未明示或暗示性地表達或保證其具有正確性、完整性或可靠性。對於簡報內容，未來若有任何變更或調整，本公司不負責更新或修正。

大綱

CONTENTS

01

公司簡介

Company Overview

02

財務資訊

Financial Information

03

進度報告

progress report

04

營運展望

Operating status

05

資訊交流

Q&A



公司簡介

Company Overview



柏騰科技(3518)

柏騰科技（台灣證券交易所 | 股票代號3518）成立1995年，為全球首家將真空濺鍍薄膜技術應用在3C產品的EMI/ESD解決方案，也為台灣證券交易所首家真空濺鍍技術公司。

- ◆ 成立時間：84.10.20
- ◆ 資本額：96,042萬元
- ◆ 董事長：黃逸駿
- ◆ 總經理：游秀屏
- ◆ 目前主要產品及其應用：
 - PVD鍍膜 – 佔比94%
 - PVD設備 – 佔比5%
 - SiC產品 – 佔比1%

關於柏騰



柏騰臺灣總部 技術開發

- 成立時間：1995年
- 資本額：9億6仟萬



EMI電磁波防護鍍膜& 外觀鍍膜產品

- 南京廠/內江廠 (PVD鍍膜&設備)
- 全球NB品牌，塑膠機殼EMI供應商龍頭
- 市占率50%，出貨約5,000萬件/年



碳化矽(SiC)晶圓

- 南崁廠(2023.1)
- 嘉義廠(建置中)
- 6~8吋碳化矽(SiC)晶圓
- 導電型(N-Type/P-Type)
- 半絕緣型(HPSI)

發展歷程

柏騰為全球首家將真空濺鍍薄膜技術應用在3C產品的EMI/ESD解決方案，目前為NB防EMI最大供應商，市佔率約50%，為業界少數具備EMI製造、PVD設備及製程設計能力。

2022年併購晶成材料擁有SiC(碳化矽)基板生產技術並進入第三代半導體供應鏈，2024年於嘉義建置首座8吋SiC基板廠。





財務資訊

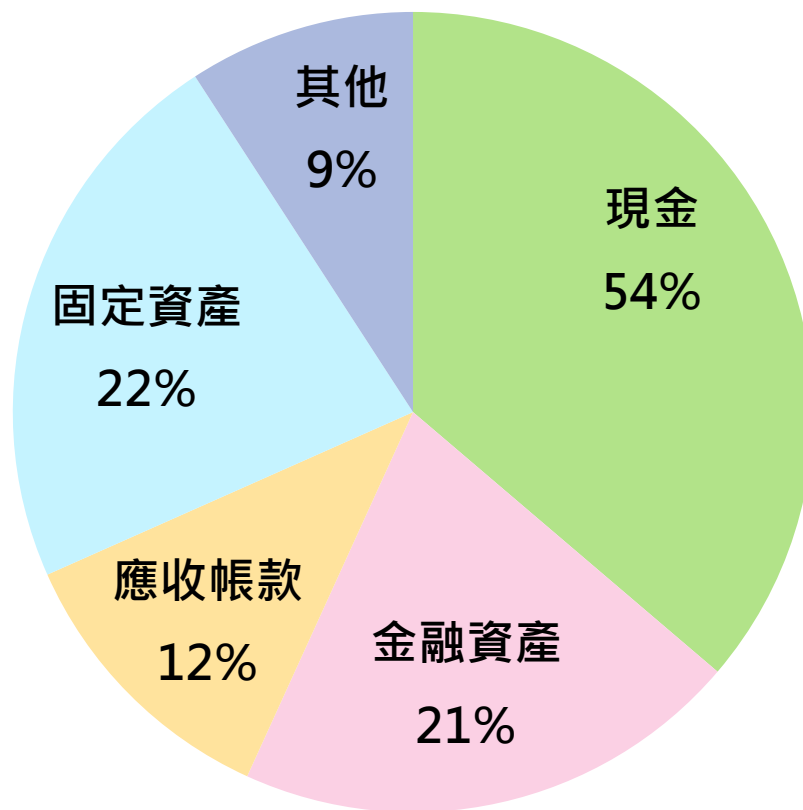
Financial Information

2025年第一季合併資產負債表

單位：新台幣佰萬元

	2025.3.31	%	2024.12.31	%	2024.03.31	%
現金及約當現金	753	36	1,069	49	722	48
金融資產-流動&非流動	427	21	228	10	56	4
應收帳款及票據	240	12	246	11	295	20
存貨	16	1	20	1	18	1
待出售非流動資產	10	0	10	0	0	0
固定資產及使用權資產	467	22	413	20	307	20
其他資產	164	8	196	9	107	7
資產總計	2,077	100	2,183	100	1,506	100
短期及一年內到期借款	174	8	171	8	174	12
其他應付款	78	4	114	5	66	4
應付公司債	286	13	284	12	0	0
長期借款	13	1	15	1	3	0
其他負債	146	7	144	7	64	4
負債總計	696	33	729	33	308	20
權益總計	1,382	67	1,455	67	1,198	80
每股淨值	14.50		15.00		14.25	

財務結構與比率



項 目	2025年Q1	2024年	2023年	2022年	2021年
負債比率	33.50	33.37	21.49	16.30	24.54
流動比率	506.59	511.45	395.27	606.50	377.86
現金流量比率	(83.41)	(33.46)	(17.17)	63.32	31.54

2025年第一季合併綜合損益表

單位：新台幣佰萬元

項目	2025年第一季	2024年第四季	增減%	2024年第一季	增減%
營業收入	74	88	(14)	80	(6)
營業毛利	1	7	(6)	21	(21)
營業費用	40	52	(12)	48	(8)
營業淨利 (損)	(39)	(45)	6	(27)	(13)
營業外收支	(33)	4	(37)	5	(38)
繼續營業單位稅前淨利	(72)	(41)	(32)	(22)	(51)
所得稅費用	19	9	10	20	(2)
繼續營業單位本期淨利 (損)	(91)	(50)	(41)	(42)	(49)
停業單位損失	1	(6)	6	(5)	6
本期淨損	(90)	(55)	(35)	(47)	(43)
毛利率 (%)	1%	8%		27%	
純益率 (%)	-122%	-57%		-58%	
每股盈餘 (元)	(0.94)	(0.58)		(0.57)	

收入與毛利率趨勢圖

單位：新台幣仟元



2025年第一季合併現金流量表

單位：新台幣佰萬元

	2025年1月1日 至3月31日	2024年1月1日 至3月31日
營業活動之淨現金流入(出)	\$(241)	\$(56)
投資活動之淨現金流入(出)	(83)	(13)
籌資活動之淨現金流入(出)	(6)	(25)
匯率變動對現金及約當現金之影響	14	15
本期現金及約當現金增(減)數	(316)	(78)
期初現金及約當現金餘額	1,069	801
期末現金及約當現金餘額	\$753	\$722

重要事件說明

- ◆ 董事會通過114年度第一季合併財務報表，114年度第一季基本每股損失新台幣0.94元。(114.05.07)
- ◆ 113年辦理現金增資發行新股經中國證監會同意備案。(114.04.21)
- ◆ 董事會決議通過以私募方式辦理現金增資發行普通股，私募額度不超過普通股25,000,000股，授權董事會自股東會決議之日起一年內分二次辦理。(114.03.12)
- ◆ 董事會通過113年度合併財務報表，113年度基本每股損失新台幣2.39元。(114.03.12)
- ◆ 董事會決議113年度不分派股利。(114.03.12)
- ◆ 子公司MACRO SIGHT INTERNATIONAL CO., LTD. 決議發放現金股利人民幣2,239萬元。(114.01.21)
- ◆ 子公司晶成材料取得SiC新廠廠務工程及裝潢工程新台幣4.45億元。(113.12.26)



進度報告

progress report

SiC新廠投資計劃

- ◆ 建廠預算：新台幣 89,953 萬元(一期)
- ◆ 新廠位置：嘉義大埔美智慧型工業園區
- ◆ 主要產品：8吋SiC晶圓
- ◆ 一期產能：3,000pcs/月
- ◆ 最大產能：6,000pcs/月

2024H2 (建置期)

ISO9001及14001認證
通過目標客戶認證
開始建置新廠廠務及工程
導入先進8吋長晶製程設備，縮短製程開發時間

2025 (新廠啟用)

~~Q1-Q3~~廠務工程完工
~~Q2-Q3~~設備move in
~~Q3-Q4~~試量產準備
~~Q4~~**2026Q1**新廠啟動
開發半絕緣產品
- 散熱基板/先進封裝
- AI/AR/5G通訊

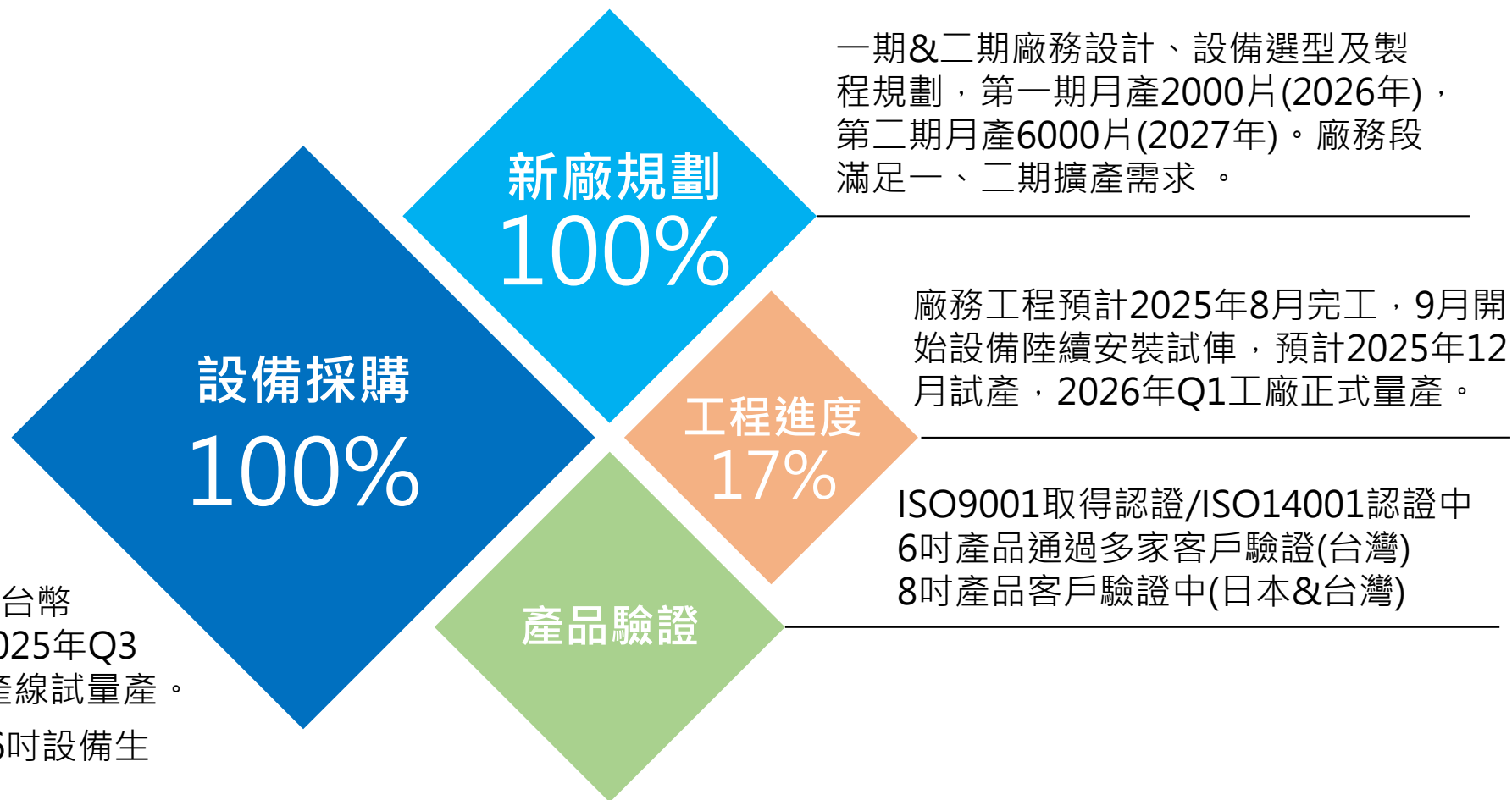
2026 (一階段)

IATF 16949認證
通過目標車用客戶認證
年產能24,000pcs
歐美目標客戶送樣
開發高階功率產品

2027 (二階段)

通過歐美車用大廠認證
進入品牌車廠供應鏈
年產能36,000pcs
進行新廠二期擴產準備
最大年產能72,000pcs

8吋廠進度說明

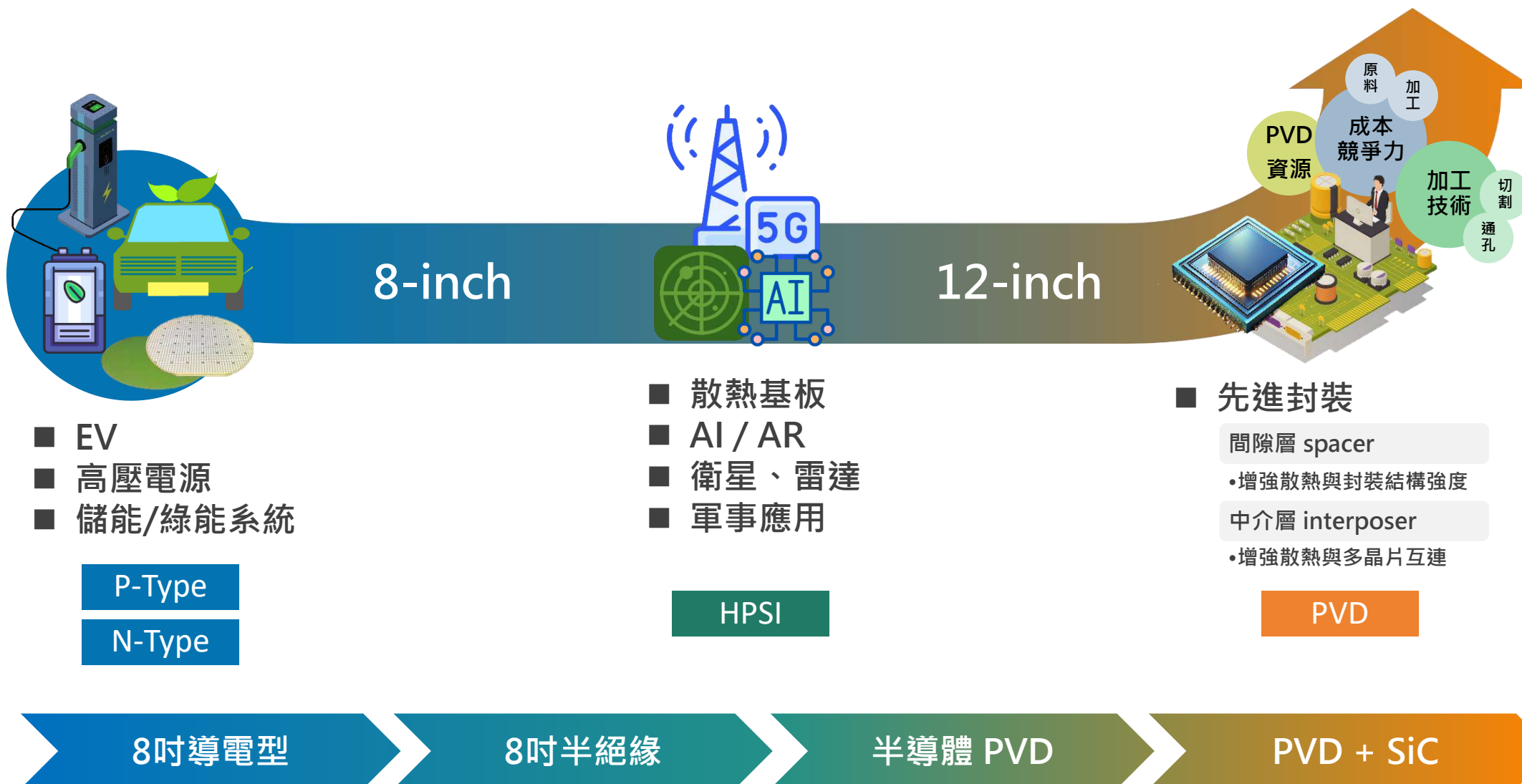




營運展望

Operating status

產品發展方向



營運展望

EMI鍍膜產品

整體經濟疲軟與關稅風險升溫，預估2025年筆電品牌全年出貨年增率將下修至1.4%，因中美關稅成本風險迫使品牌採取更保守的生產與採購策略，短期輸美市場產品產能將加速移出中國大陸，中國EMI訂單影響仍需持續觀察。

PVD鍍膜技術

真空濺鍍(PVD)鍍膜技術應用範圍相當廣泛，尤其為符合ESG及環保減碳的趨勢潮流下，將PVD鍍膜技術應用在功能鍍膜及外觀表面處理。

- (1)AF鍍膜 - NB產品
- (2)類陽極鍍膜 - NB、3C產品
- (3)功能鍍膜 - 電子元件、基板、先進封裝應用。

SiC晶圓產品

8吋SiC晶圓相較6吋晶圓，單位晶片成本可降低35%，全球8吋晶圓廠陸續於2024年底開始投產進入量產，隨著全球廠商積極佈局產能、技術突破以及成本下降，預計2026年起將進入大規模商業化階段，國外研調機構預估2026年至2033年的8吋SiC晶圓年均成長率(CAGR)可達18.5%。

SiC加工服務

- (1)6~8吋晶錠加工
- (2)SiC再生晶圓(Reclaim)

新廠具備晶體加工產能，加工月產能可達7200片，就近提供國內6吋及8吋長晶廠晶圓加工及磊晶廠SiC再生晶圓(Reclaim)服務。



資訊交流

Q&A

TRUE PARTNER FOR A BRIGHTER FUTURE



發言人：劉明怡 財務處副總

電話：(03)212-8833

E-mail：mingi@pttech.com.tw.